

L-6524C2

L-6524C1

(両面板)
W - Sided Copper Clad Laminates
(片面板)
S - Sided Copper Clad Laminates

[UV遮蔽タイプ:L-6524C2 UV]
W - sided Copper Clad Laminates of UV shielding type:L-6524C2 UV

ガラス布・ガラス不織布基材エポキシ樹脂銅張積層板 (CEM-3) Glass fabric, glass non-woven fabric base epoxy resin copper-clad laminates (CEM-3)

■特長 Characteristic

- 放熱性に優れています(熱伝導率 0.9 W/(m・K))。
Heat dissipation is excellent. Thermal conductivity 0.9 W/(m・K).
- パンチング加工が可能です。
Punching work is available.

■用途 Use applications

- アミューズメント機器 For amusement components
- LED照明機器、他 For LED lighting equipment, others
- 自動車用電子機器 For automotive components
- 産業機器用電子機器 For industrial equipment

■仕様 Specification

●両面板、片面板 Copper clad laminates

| 品番 Products | 定尺寸法 (縦×横) Standard size (Lw × Cw) | 銅箔厚さ Copper foil thickness | 公称板厚 Nominal thickness | 厚さ許容差 Thickness tolerance |
|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | 両面板、片面板 W / S - sided CCL |
| L-6524C2 L-6524C1 | 1,020 ⁺¹⁰ / ₋₀ × 1,020 ⁺¹⁰ / ₋₀ mm | 18 μm 35 μm 70 μm | 0.8mm | ±0.17 |
| | | | 1.0mm | ±0.18 |
| | | | 1.2mm | ±0.19 |
| | | | 1.6mm | ±0.19 |
| L-6524C1 | 1,020 ⁺¹⁰ / ₋₀ × 1,220 ⁺¹⁰ / ₋₀ mm | 18 μm 35 μm 70 μm | 0.8mm | ±0.17 |
| | | | 1.0mm | ±0.18 |
| | | | 1.2mm | ±0.19 |
| | | | 1.6mm | ±0.19 |

■一般特性例 Properties

| 試験項目 Item | | 処理条件 Treatment | 単位 Unit | 実測値 Actual value |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|
| ガラス転移温度(Tg) Glass transition temp | TMA | 昇温:10°C/min Heating rate:10°C/min | °C | 130 |
| | DSC | 昇温:20°C/min Heating rate:20°C/min | °C | 130 |
| 熱膨張係数 Coefficient of thermal expansion | X(横) | TMA | ppm/°C | 18 |
| | Y(縦) | | ppm/°C | 21 |
| | Z | | ppm/°C | 60 |
| | | | ppm/°C | 310 |
| 熱分解温度(Td) Decomposition temp | TG/DTA法(5%重量減少) (5% weight loss) | 昇温:20°C/min Heating rate:20°C/min | °C | 380 |
| 熱伝導率 Thermal conductivity | LF法 Laser flash method | A | W/(m・K) | 0.9 |
| 比熱容量 Specific heat capacity | LF法 Laser flash method | A | J/(g・K) | 1.2 |
| はんだ耐熱性 260°C Solder heat resistance at 260°C | | A | 秒 sec. | ≥120 |
| T ₂₈₈ Time to delamination | TMA | TMA | 分 min | 20 |
| 銅箔引き剥がし強さ Peel strength | 18 μm | A | N/mm | 1.5 |
| | | S ₄ | | 1.5 |
| | 35 μm | A | | 1.9 |
| | | S ₄ | | 1.9 |
| 曲げ強さ Flexural strength | 縦 Lw / 横 Cw | A | MPa | 380 / 290 |
| 曲げ弾性率 Flexural modulus | 縦 Lw / 横 Cw | A | GPa | 14 / 12 |
| 比誘電率 Dielectric constant (Dk) | 1MHz | C-96/20/65 | — | 4.8 |
| | 1GHz | | — | 4.3 |
| 誘電正接 Dissipation factor (Df) | 1MHz | C-96/20/65 | — | 0.020 |
| | 1GHz | | — | 0.022 |
| 体積抵抗率 | Volume resistivity | C-96/20/65 | MΩ・m | 1×10 ⁸ |
| 表面抵抗 | Surface resistance | C-96/20/65 | MΩ | 1×10 ⁹ |
| 絶縁抵抗 | Insulation resistance | C-96/20/65 | MΩ | 1×10 ⁹ |
| 比較トラッキング指数(CTI値) Comparative tracking index (CTI) | | A | V | 175 |
| 吸水率 | Water absorption | E-24/50 + D-24/23 | % | 0.04 |
| 耐アルカリ性(3%NaOH溶液) Alkali resistance(3% NaOH aq) | | 40°C/3min 浸漬 Dip | — | 異常なし No remarkable change |
| UV透過率(UV遮蔽タイプ) UV transmittance of UV shielding type | UV-35 | A | % | 0.02 |
| | UV-42 | A | % | 2.01 |
| 耐燃性 UL94 | Flammability UL94 | E-24/125 | — | 94V-0 |

* 1 上記試験はJIS C 6481、IPC TM650、IEC-60112、UL規格に準じます。

*1 The above tests are in accordance with JIS C6481, IPC TM650, IEC-60112, and UL.

* 2 試験板厚は1.6mmです。

*2 The sample thickness is 1.6mm.

* 3 上記は実測値であり、保証値ではございません。

*3 The above data is actual values and not guaranteed values.